

# 上海南芯半导体科技股份有限公司 关于变更公司注册资本、公司类型、修订《公司章程》 并办理登记机关变更登记的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

上海南芯半导体科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 5 月 25 日召开了公司第一届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型、修订<公司章程>并办理登记机关变更登记的议案》。现将有关情况公告如下：

## 一、注册资本等变更情况

根据中国证券监督管理委员会于 2023 年 2 月 21 日出具的《关于同意上海南芯半导体科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可（2023）365 号），公司获准向社会公开发行人民币普通股 6,353 万股，每股发行价格为人民币 39.99 元，公司股票于 2023 年 4 月 7 日在上海证券交易所上市。本次发行后公司的注册资本由 36,000 万元增加至 42,353 万元人民币，公司类型由股份有限公司（非上市、外商投资企业投资）变更为股份有限公司（上市）。具体以工商变更登记为准。

根据公司于 2022 年 6 月 29 日召开的 2021 年年度股东大会审议通过的《关于变更公司住所、修订<公司章程>及办理登记机关变更登记的议案》，公司住所已变更为“中国（上海）自由贸易试验区盛夏路 565 弄 54 号（4 幢）1601”。

## 二、章程修订情况

鉴于上述变更情况，现拟对《上海南芯半导体科技股份有限公司章程(草案)》

(以下简称“《公司章程(草案)》”)中的有关条款进行修订,并将其名称变更为《上海南芯半导体科技股份有限公司章程》,同时拟提请公司股东大会授权公司董事会办公室负责办理后续工商变更登记、章程备案等事宜。

具体修订情况如下:

	修改前	修改后
第三条	公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可【】【】号)核准,首次向社会公众发行人民币普通股【】万股,于【】年【】月【】日在上海证券交易所上市。	公司于2023年2月21日经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)(证监许可〔2023〕365号)同意,首次向社会公众发行人民币普通股6,353万股,于2023年4月7日在上海证券交易所上市。
第四条	公司注册名称“中文名称”:上海南芯半导体科技股份有限公司 英文名称:【英文全称】	公司注册名称“中文名称”:上海南芯半导体科技股份有限公司 英文名称: Southchip Semiconductor Technology(Shanghai) Co., Ltd.
第五条	公司住所:中国(上海)自由贸易试验区晨晖路1000号214室 邮政编码:200120	公司住所:中国(上海)自由贸易试验区盛夏路565弄54号(4幢)1601 邮政编码:200120
第六条	公司注册资本为人民币36,000万元。	公司注册资本为人民币42,353万元。
第二十条	公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股,均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为【】万股,均为普通股。	公司首次公开发行前的股份总数为36,000万股,均为普通股;公司首次公开发行后的股份总数为42,353万股,均为普通股。
第二百一十二条	本章程自股东大会批准并于公司首次公开发行股票并在证券交易所挂牌交易之日生效。	本章程自股东大会审议通过后生效。

除上述修订条款外,《公司章程(草案)》中其他条款保持不变。以上内容最终以工商登记机关核准的内容为准。修订后的《公司章程》全文将于同日通过上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)予以披露。

特此公告。

上海南芯半导体科技股份有限公司董事会

2023年5月27日